

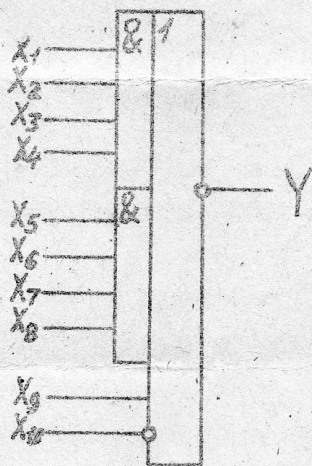


П А С П О Р Т

Микросхема типа КЛР554 соответствует техническим условиям О.348.006 ТУ

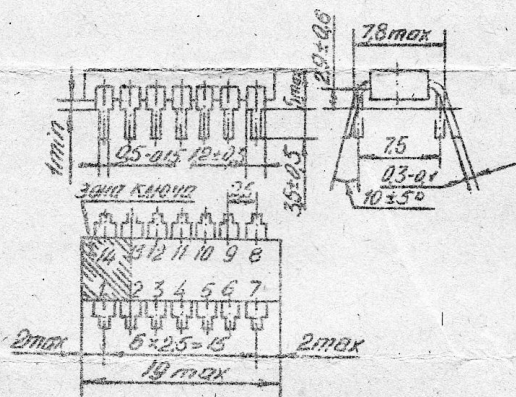
I. Функциональное назначение - логический элемент "4-И-2ИЛИ-НЕ" с возможностью расширения по "ИЛИ"

Таблица I



$$Y = X_1 X_2 X_3 X_4 \vee X_5 X_6 X_7 X_8 \vee \dots$$

Вывод	Назначение
1	Вход X ₁
2	Вход X ₂
3	Вход X ₃
4	Вход X ₄
5	Вход расширительный X ₉
6	-
7	Общий
8	Выход Y
9	Вход расширительный X ₁₀
10	Вход X ₅
11	Вход X ₆
12	Вход X ₇
13	Вход X ₈
14	Питание E



3. Масса микросхемы, не более 1 г
4. Содержание золота в одной микросхеме 0,006821 г
5. Напряжение питания E = +5 В ± 5%
6. Электрические параметры при температуре +20±5°C

Таблица 2

Наименование	Норма
Нагрузочная способность, N	10
Время задержки выключения t ₃ ⁰¹ , нс, не более	22
Время задержки включения t ₃ ¹⁰ , нс, не более	15
Выходное напряжение "лог.0", U ⁰ _{вых} , В, не более	0,4
Выходное напряжение "лог.1", U ¹ _{вых} , В, не менее	2,4

7. Пределы допустимые условия эксплуатации.

Диапазон рабочей температуры от минус 10 до +70°C.

Пределно допустимое кратковременное напряжение питания составляет 7 В в течение времени 5 миллисекунд.

8. Срок хранения - 12 лет.

9. Время гарантийной наработки.

Гарантируется соответствие микросхемы требованиям технических условий при наработке 10000 часов. Гарантии исчисляются со дня отгрузки микросхемы потребителю.

10. Указания и рекомендации по эксплуатации.

Крепление микросхемы к печатной плате в аппаратуре может быть произведено методом пайки выводов.

Расстояние от места пайки вывода до корпуса микросхемы должно быть не менее 2,5 мм.

Пайку следует производить с принятием мер, исключающих повреждение микросхемы из-за перегрева и механических усилий.

При пайке рекомендуется применять припой ПОС-61 ГОСТ 1499-70 и флюс ФКСИ по НО.054.063. При пайке с помощью паяльника последний должен быть обязательно заземлен и иметь мощность не более 60 Вт.

При пайке температура не должна превышать 260°C, а время воздействия этой температуры на микросхему не более 5 с.

После монтажа микросхема должна быть защищена в соответствии с нормами НО.054.021.

С целью повышения надежности аппаратуры рекомендуется принимать меры, обеспечивающие минимальную температуру нагрева корпуса микросхем и защиту от воздействия климатических факторов.

При ремонте аппаратуры замену микросхем необходимо производить только при отключенных источниках питания.

Дата выпуска август 1975

